

Doc. No.: NR051117

2005年11月17日

ウエハーへのダメージを大幅に軽減する「CMPスラリー供給装置」を発売 ～半導体製造業界における装置販売事業へ本格的に参入～

大日本スクリーン製造株式会社(本社：京都市上京区／社長：橋本 正博)が100%出資するグループ会社、株式会社SEBACS(本社：京都市右京区／社長：筒井 昭男)は、研磨工程におけるウエハーへのダメージを大幅に軽減する「CMPスラリー^{セバックス}*供給装置」を、12月1日から販売します。

現在、半導体業界ではプロセス技術の微細化が進み、線幅90ナノメートル(ナノは10億分の1)への移行だけでなく、65ナノメートル以後の次世代プロセスの開発も本格化しています。そのため、ウエハーの研磨工程においては、微細化するプロセス技術に対応する研磨剤の開発や、研磨方法の最適化が進められています。

今回発売する「CMPスラリー供給装置」は、最先端デバイスの各製造工程で実績のある供給装置に、研磨剤そのものへのダメージを抑えながら供給できる新方式ポンプを新たに搭載。従来方式のポンプによる送液において課題となっていた微細なごみの発生、研磨剤の滞留などを解消できるため、研磨工程でのウエハーへのダメージが大幅に軽減され、デバイス不良の低減による生産性の向上に貢献します。さらに、供給経路の状態変化に合わせて研磨剤を最小限の流量で安定供給できるため、高価な研磨剤の消費を抑えるとともに、流路に設置されたフィルターの交換頻度を低減でき、ランニングコストの削減が可能となります。また、研磨剤の廃棄量を抑えることにより、環境にも配慮した装置となっています。

当社は、2003年8月の設立以来、大日本スクリーンが販売する半導体製造装置の、搬入・据え付け・保守などの技術サービスを全面的に手掛けており、2004年からは新規事業として、薬液供給ユニットなど半導体業界向けの周辺機器の製造・販売を開始しています。当社は今回の「CMPスラリー供給装置」の販売により、製品ラインアップを充実させるとともに、半導体製造業界における装置販売事業への本格的な参入を図ります。

なお、この装置は12月7日から9日まで千葉「幕張メッセ」で開催される「SEMICON Japan 2005」において、実機を展示します。

※ CMPスラリー

半導体の製造工程において、ウエハー表面を研磨し平坦化するときに使用する研磨剤。CMPは「Chemical Mechanical Polishing」の略で、日本語では「化学的機械研磨」と呼ばれている。

<販売開始予定>

2005年12月1日

<国内希望販売価格(消費税別)>

約2,000万円～(仕様によって異なります)

<年間販売予定台数>

10台



CMPスラリー供給装置

●本件についてのお問い合わせ先

株式会社 **SEBACS**® 本社新事業推進室：Tel 075-323-2080 Fax 075-323-2075 〒615-0864 京都市右京区西京極新明町 13-1